

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

61076-4-100

QC 480301XX0001

Deuxième édition  
Second edition  
2001-11-01

---

---

**Connecteurs pour équipements électroniques –**

**Partie 4-100:**

**Connecteurs pour cartes imprimées  
sous assurance de la qualité –**

**Spécification particulière pour les modules de  
connecteurs en deux parties pour cartes  
imprimées et fonds de panier, au pas de 2,5 mm**

**Connectors for electronic equipment –**

**Part 4-100:**

**Printed board connectors with assessed quality –  
Detail specification for two-part connector  
modules having a grid of 2,5 mm for printed  
boards and backplanes**

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni  
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé,  
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  
microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in  
any form or by any means, electronic or mechanical,  
including photocopying and microfilm, without permission in  
writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE XB

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	10
1 Données générales.....	16
1.1 Méthode recommandée pour le montage.....	16
1.2 Caractéristiques et conditions nominales de fonctionnement.....	16
1.3 Références normatives.....	18
1.4 Marquage.....	18
1.5 Désignation de type CEI.....	20
1.6 Références pour les commandes.....	20
2 Données techniques.....	22
2.1 Définitions.....	22
2.1.1 Disposition de contacts mâles pour fond de panier.....	22
2.2 Tableau des modèles et des variantes.....	24
2.3 Renseignements sur l'application.....	26
2.3.1 Connecteurs complets (paires).....	26
2.3.2 Embases.....	28
2.3.3 Fiches.....	28
2.3.4 Accessoires.....	28
2.3.5 Blindage et continuité de masse.....	28
2.3.6 Types de base de sortie.....	28
2.4 Dispositions des contacts.....	30
2.4.1 Embases.....	30
2.4.2 Fiches.....	32
3 Renseignements concernant les dimensions.....	34
3.1 Généralités.....	34
3.2 Vue isométrique et caractéristiques communes.....	36
3.2.1 Caractéristiques communes.....	38
3.2.2 Système de référence.....	38
3.2.3 Dimensions en hauteur.....	40
3.2.4 Dimensions en largeur.....	42
3.2.5 Dimensions en profondeur.....	44
3.3 Renseignements concernant l'accouplement.....	46
3.3.1 Longueur d'enfichage électrique.....	46
3.3.2 Inclinaison.....	50
3.3.3 Planéité.....	50
3.4 Embases.....	50
3.4.1 Dimensions.....	50
3.4.2 Sorties.....	64
3.5 Fiches.....	66
3.5.1 Dimensions.....	66
3.5.2 Sorties.....	76
3.6 Accessoires.....	76
3.7 Renseignements sur le montage des embases.....	78
3.7.1 Plan de perçage sur panneau.....	78
3.8 Renseignements sur le montage des fiches.....	80
3.8.1 Plan de perçage sur cartes imprimées.....	80
3.8.2 Prescriptions pour les outils d'insertion à force.....	82

## CONTENTS

FOREWORD .....	11
1 General data .....	17
1.1 Recommended method of mounting .....	17
1.2 Ratings and characteristics .....	17
1.3 Normative references .....	19
1.4 Marking .....	19
1.5 IEC type designation .....	21
1.6 Ordering information .....	21
2 Technical information .....	23
2.1 Definitions .....	23
2.1.1 Backplane male contact arrangement .....	23
2.2 Survey of styles and variants .....	25
2.3 Information on application .....	27
2.3.1 Complete connectors (pairs) .....	27
2.3.2 Fixed board connectors .....	29
2.3.3 Free board connectors .....	29
2.3.4 Accessories .....	29
2.3.5 Shielding/grounding .....	29
2.3.6 Basic type of termination .....	29
2.4 Contact arrangements .....	31
2.4.1 Fixed board connectors .....	31
2.4.2 Free board connectors .....	33
3 Dimensional information .....	35
3.1 General .....	35
3.2 Isometric view and common features .....	37
3.2.1 Common features .....	39
3.2.2 Reference system .....	39
3.2.3 Height dimensions .....	41
3.2.4 Width dimensions .....	43
3.2.5 Depth dimensions .....	45
3.3 Engagement (mating) information .....	47
3.3.1 Electrical engagement length .....	47
3.3.2 Inclination .....	51
3.3.3 Planarity .....	51
3.4 Fixed board connectors .....	51
3.4.1 Dimensions .....	51
3.4.2 Terminations .....	65
3.5 Free board connectors .....	67
3.5.1 Dimensions .....	67
3.5.2 Terminations .....	77
3.6 Accessories .....	77
3.7 Mounting information for fixed board connectors .....	79
3.7.1 Hole pattern on panels .....	79
3.8 Mounting information for free board connectors .....	81
3.8.1 Hole pattern on printed boards .....	81
3.8.2 Requirements for press-in tools .....	83

3.9	Calibres.....	84
3.9.1	Calibres de forçage et calibres de force de rétention .....	84
4	Caractéristiques .....	86
4.1	Catégorie climatique.....	86
4.2	Caractéristiques électriques .....	86
4.2.1	Lignes de fuite et distances dans l'air.....	86
4.2.2	Tension de tenue (applicable pour PL1, 2, 3).....	86
4.2.3	Courant limite (applicable pour PL1, 2, 3).....	88
4.2.4	Résistance de contact .....	90
4.2.5	Résistance d'isolement.....	90
4.3	Caractéristiques mécaniques.....	92
4.3.1	Fonctionnement mécanique .....	92
4.3.2	Forces d'insertion et d'extraction .....	92
4.3.3	Rétention du contact dans l'isolant .....	92
4.3.4	Charge statique axiale.....	92
4.3.5	Vibrations (sinusoïdales) .....	92
5	Programme d'essais .....	94
5.1	Généralités.....	94
5.1.1	Disposition pour la mesure de la résistance de contact.....	98
5.1.2	Disposition pour les essais de contrainte dynamique.....	98
5.1.3	Disposition pour les essais de charge statique axiale .....	98
5.1.4	Disposition de câblage pour essai de résistance d'isolement, de tension de tenue et de polarisation pendant l'essai de chaleur humide .....	100
5.1.5	Disposition pour l'essai d'inflammabilité.....	100
5.1.6	Dispositif pour la mesure des connexions CIF (connecteur femelle).....	102
5.1.7	Planéité des conducteurs .....	104
5.1.8	Cartes imprimées d'essai pour embases et fiches.....	106
5.2	Tableaux de programmes d'essai .....	108
5.2.1	Groupe préliminaire P.....	108
5.2.2	Groupe AP – Essais dynamiques/climatiques .....	110
5.2.3	Groupe EP – Endurance mécanique .....	116
5.2.4	Groupe CP – Humidité.....	118
5.2.5	Groupe LP – Charge électrique.....	120
5.2.6	Groupe EP – Essais mécaniques.....	122
5.2.7	Groupe FP – Fluides chimiques .....	124
5.2.8	Groupe GP – Connexions .....	124
6	Procédures de contrôle de la qualité.....	126
6.1	Essais d'homologation.....	126
6.1.1	Méthode 1 .....	126
6.1.2	Méthode 2 .....	128
6.2	Contrôle de conformité de la qualité .....	128
6.2.1	Essais lot par lot.....	128
6.2.2	Essais périodiques .....	130
6.3	Livraison retardée, nouveau contrôle.....	132
	Annexe A (normative) Structures mécaniques.....	134

3.9	Gauges .....	85
3.9.1	Sizing gauges and retention force gauges .....	85
4	Characteristics .....	87
4.1	Climatic category.....	87
4.2	Electrical .....	87
4.2.1	Creepage and clearance distances .....	87
4.2.2	Voltage proof (applicable for PL1, 2, 3).....	87
4.2.3	Current-carrying capacity (applicable for PL1, 2, 3) .....	89
4.2.4	Contact resistance.....	91
4.2.5	Insulation resistance.....	91
4.3	Mechanical.....	93
4.3.1	Mechanical operation.....	93
4.3.2	Insertion and withdrawal forces .....	93
4.3.3	Contact retention in insert.....	93
4.3.4	Static load, axial.....	93
4.3.5	Vibration (sinusoidal).....	93
5	Test schedule.....	95
5.1	General.....	95
5.1.1	Arrangement for contact resistance measurement .....	99
5.1.2	Arrangement for dynamic stress tests.....	99
5.1.3	Arrangement for testing static load, axial .....	99
5.1.4	Wiring arrangement for insulation resistance, voltage proof and polarization voltage during damp heat test.....	101
5.1.5	Arrangement for flammability test.....	101
5.1.6	Arrangement for measurement of the press-in connections (female connector).....	103
5.1.7	Planarity of mounted connectors.....	105
5.1.8	Test board for fixed and flexible board connectors.....	107
5.2	Test schedule tables .....	109
5.2.1	Preliminary group .....	109
5.2.2	Group AP – Dynamic/climatic .....	111
5.2.3	Group BF – Mechanical endurance.....	117
5.2.4	Group CP – Moisture .....	119
5.2.5	Group DP – Electrical load .....	121
5.2.6	Group EP – Mechanical resistivity .....	123
5.2.7	Group FP – Chemical fluids .....	125
5.2.8	Group GP – Connections .....	125
6	Quality assessment procedures .....	127
6.1	Qualification approval testing .....	127
6.1.1	Method 1 .....	127
6.1.2	Method 2 .....	129
6.2	Quality conformance inspection.....	129
6.2.1	Lot-by-lot tests .....	129
6.2.2	Periodic tests.....	131
6.3	Delayed delivery, re-inspection.....	133
	Annex A (normative) Mechanical structures .....	135

Figure 1 – Disposition de contacts mâles pour fond de panier.....	22
Figure 2 – Fiches et embases pour disposition modulaire.....	26
Figure 3 – Disposition des contacts.....	30
Figure 4 – Dispositions des contacts.....	32
Figure 5 – Vue isométrique.....	36
Figure 6 – Dimensions en hauteur.....	40
Figure 7 – Dimensions en largeur.....	42
Figure 8 – Dimensions en profondeur.....	44
Figure 9 – Conditions d'accouplement.....	46
Figure 10 – Premier point de contact.....	47
Figure 11 – Direction perpendiculaire à celle de l'enfichage (accouplement).....	48
Figure 12 – Inclinaison.....	50
Figure 13 – Modèle A.....	52
Figure 14 – Détails de W et X et vues de U et V.....	54
Figure 15 – Modèle B.....	56
Figure 16 – Modèle D.....	58
Figure 17 – Modèle G.....	60
Figure 18 – Modèle H.....	62
Figure 19 – Sorties.....	64
Figure 20 – Modèle A.....	66
Figure 21 – Vue X et détails U, V, W, Y, Z.....	68
Figure 22 – Modèle B.....	70
Figure 23 – Modèle D.....	72
Figure 24 – Modèle G.....	74
Figure 25 – Modèle H.....	76
Figure 26 – Sorties.....	76
Figure 27 – Plan de perçage sur anneau.....	78
Figure 28 – Plan de perçage sur cartes imprimées.....	80
Figure 29 – Plan de perçage sur cartes imprimées.....	82
Figure 30 – Dimensions des calibres.....	84
Figure 31 – Courant limite.....	88
Figure 32 – Points de mesure.....	90
Figure 33 – Dispositions pour les essais de contrainte dynamique.....	98
Figure 34 – Câblage des spécimens.....	100
Figure 35 – Disposition pour l'essai d'inflammabilité.....	100
Figure 36 – Dispositions pour la mesure des connexions insérées à force (connecteur temelle).....	102
Figure 37 – Planéité des connecteurs montés.....	104
Figure 38 – Carte imprimée d'essai pour embases et fiches.....	106
Figure A.1 – Dimension d'unité enfichable.....	136

Figure 1 – Backplane male contact arrangement.....	23
Figure 2– Free and fixed board connectors for modular arrangement.....	27
Figure 3 – Contact arrangements.....	31
Figure 4 – Contact arrangements.....	33
Figure 5 – Isometric view.....	37
Figure 6 – Height dimensions.....	41
Figure 7 – Width dimensions.....	43
Figure 8 – Depth dimensions.....	45
Figure 9 – Mating conditions.....	47
Figure 10 – First contact point.....	47
Figure 11 – Perpendicular to engagement (mating) direction.....	49
Figure 12 – Inclination.....	51
Figure 13 – Style A.....	53
Figure 14 – Details W and X and views U and V.....	55
Figure 15 – Style B.....	57
Figure 16 – Style D.....	59
Figure 17 – Style G.....	61
Figure 18 – Style H.....	63
Figure 19 – Terminations.....	65
Figure 20 – Style A.....	67
Figure 21 – View X and details U, V, W, Y and Z.....	69
Figure 22 – Style B.....	71
Figure 23 – Style D.....	73
Figure 24 – Style G.....	75
Figure 25 – Style H.....	77
Figure 26 – Terminations.....	77
Figure 27 – Hole pattern on panel.....	79
Figure 28 – Hole pattern on printed boards.....	81
Figure 29 – Hole pattern on printed boards.....	83
Figure 30 – Gauge dimensions.....	85
Figure 31 – Current-carrying capacity.....	89
Figure 32 – Measuring points.....	91
Figure 33 – Dynamic stress tests arrangements.....	99
Figure 34 – Wiring of specimen.....	101
Figure 35 – Arrangement for flammability test.....	101
Figure 36 – Press-in connections (female connector) measurement arrangements.....	103
Figure 37 – Planarity of mounted connectors.....	105
Figure 38 – Test board for fixed and free board connectors.....	107
Figure A.1 – Plug-in unit dimension.....	137

Tableau 1 – Tension assignée .....	16
Tableau 2 – Disposition des contacts et nombre de contacts .....	24
Tableau 3 – Modèles de sorties .....	24
Tableau 4 – Vue isométrique et caractéristiques communes .....	38
Tableau 5 – Dimensions en hauteur .....	40
Tableau 6 – Dimensions en largeur .....	42
Tableau 7 – Dimensions en profondeur .....	44
Tableau 8 – Plages de performance de contact sûr .....	46
Tableau 9 – Dimensions des sorties .....	64
Tableau 10 – Plan de perçage sur panneau .....	72
Tableau 11 – Plan de perçage sur cartes imprimées .....	82
Tableau 12 – Calibres .....	84
Tableau 13 – Catégorie climatique .....	86
Tableau 14 – Lignes de fuite et distances dans l'air minimales .....	86
Tableau 15 – Tension de tenue .....	86
Tableau 16 – Courant limite à 70 °C .....	88
Tableau 17 – Nombre de manœuvres mécaniques .....	92
Tableau 18 – Forces d'insertion et d'extraction .....	92
Tableau 19 – Sévérité des vibrations .....	92
Tableau 20 – Nombre de spécimens .....	96
Tableau 21 – Essais de contrainte dynamique .....	98
Tableau 22 – Carte imprimée d'essai pour embases et fiches .....	106
Tableau 23 – Niveaux de performance .....	126
Tableau 24 – Essais lot par lot .....	128
Tableau 25 – Essais périodiques .....	130
Tableau 26- Livraison retardée, nouveau contrôle .....	132
Tableau A.1 – Dimensions exigées conformément à la CEI 60917-2-2 .....	134

Table 1 – Rated voltage.....	17
Table 2 – Contact arrangement and number of contacts .....	25
Table 3 – Styles of termination.....	25
Table 4 – Isometric view and common features.....	39
Table 5 – Height dimensions.....	41
Table 6 – Width dimensions .....	43
Table 7 – Depth dimensions.....	45
Table 8 – Ranges of safe contact performance .....	47
Table 9 – Dimensions of terminations .....	65
Table 10 – Hole pattern on panels .....	77
Table 11 – Hole pattern on printed boards .....	83
Table 12 – Gauges .....	85
Table 13 – Climatic category.....	87
Table 14 – Minimum creepage and clearance distances.....	87
Table 15 – Voltage proof.....	87
Table 16 – Current-carrying capacity at 70 °C.....	89
Table 17 – Number of mechanical operations .....	93
Table 18 – Insertion and withdrawal forces .....	93
Table 19 – Vibration severity.....	93
Table 20 – Number of specimens.....	97
Table 21 – Dynamic stress tests .....	99
Table 22 – Test board for fixed and free board connectors.....	107
Table 23 – Performance levels.....	127
Table 24 – Lot-by-lot tests .....	129
Table 25 – Periodic tests .....	131
Table 26 – Delayed delivery, re-inspection.....	133
Table A.1 – Dimensions required in accordance with IEC 60917-2-2.....	135

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –**

**Partie 4-100: Connecteurs pour cartes imprimées  
sous assurance de la qualité –  
Spécification particulière pour les modules de connecteurs  
en deux parties pour cartes imprimées et fonds de panier,  
au pas de 2,5 mm**

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux des Comités nationaux intéressés par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61076-4-100 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Cette seconde édition annule et remplace la première édition, parue en 1994, et constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48B/1086/FDIS	48B/1117/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors d'une prochaine édition.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT –****Part 4-100: Printed board connectors with assessed quality –  
Detail specification for two-part connector modules  
having a grid of 2,5 mm for printed boards and backplanes**

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61076-4-100 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition, issued in 1994, and constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
48B/1086/FDIS	48B/1117/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing standards in this series will be updated when a new edition is prepared.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A fait partie intégrante de la présente spécification.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

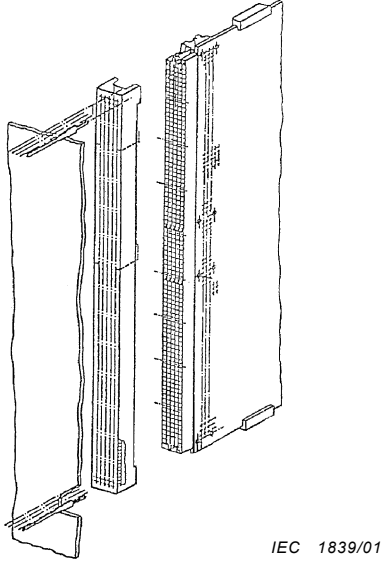
Annex A forms an integral part of this specification.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2004. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

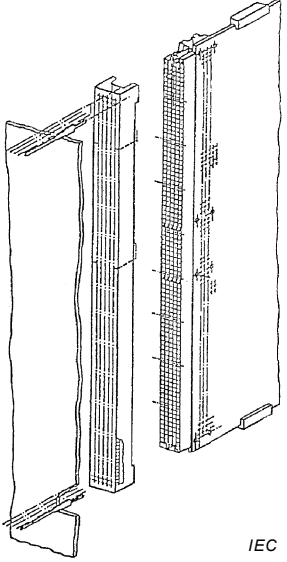
## CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

### Partie 4-100: Connecteurs pour cartes imprimées sous assurance de la qualité – Spécification particulière pour les modules de connecteurs en deux parties pour cartes imprimées et fonds de panier, au pas de 2,5 mm

<p><b>CEI SC 48B: Connecteurs BF</b></p> <p>Cette spécification peut être obtenue auprès de: Bureau Central de la CEI ou à l'une des adresses indiquées sur la couverture intérieure.</p> <p>COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES DE QUALITÉ ASSURÉE CONFORMES À:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LA SPÉCIFICATION GÉNÉRIQUE CEI 61076-1 Première édition: 1995</li> </ul>	<p><b>CEI 61076-4-100</b> <b>QC 480301XX0001</b></p> <p>Page 14 de 137 pages</p>
<p>Voir l'article 3 pour les dimensions</p>  <p style="text-align: right;"><i>IEC 1839/01</i></p>	<p>Connecteur modulaire en deux parties pour cartes imprimées et fonds de panier, au pas de 2,5 mm conforme à la CEI 60917</p> <p>Connecteur avec modules multiples de hauteur <math>n \times 25</math> mm (avec <math>n = 1, 2, 4, 9, 10</math>) et 5 rangées</p> <p>Niveaux de performance (PL): 1, 2, 3 Niveaux de contrôle: B et G *)</p> <p>Combinaisons de niveaux de performance et de contrôle: 1G, 2B, 2G, 3B</p>
<p>*) Voir 6.2 et 6.3.</p>	

## CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT –

### Part 4-100: Printed board connectors with assessed quality – Detail specification for two-part connector modules having a grid of 2,5 mm for printed boards and backplanes

<p><b>IEC SC 48B: LF connectors</b></p> <p>Specification available from: IEC Central Office or from the addresses shown on the inside cover.</p> <p>ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IN ACCORDANCE WITH:</p> <p>– GENERIC SPECIFICATION IEC 61076-1 First edition:1995</p>	<p><b>IEC 61076-4-100</b> <b>QC 480301XX0001</b></p> <p>Page 15 of 138 pages</p>
<p>See clause 3 for dimensions</p>  <p style="text-align: right;">IEC 1839/01</p>	<p>Modular two-part connector for printed boards and backplanes, grid of 2,5 mm in accordance with IEC 60917</p> <p>Connector with height multiple modules <math>n \times 25</math> mm, (with <math>n = 1, 2, 4, 9, 10</math>) five rows</p> <p>Performance levels (PL): 1, 2, 3 Assessment levels: B and G <sup>*)</sup> Combinations of performance and assessment levels: 1G, 2B, 2G, 3B</p>
<p>*) See 6.2 and 6.3.</p>	

## 1 Données générales

### 1.1 Méthode recommandée pour le montage

Les fiches sont munies de contacts à souder ou à insérer à force. Le maintien de la fiche est réalisé au moyen de bornes insérées à force. Les sorties des fiches doivent être adaptées aux trous des cartes imprimées, disposés sur une grille de 2,5 mm conformément à la CEI 60326-3.

Les embases sont munies soit:

- de contacts à insérer à force;
- de contacts à insérer à force et connexions enroulées;
- de contacts à insérer à force et connexions enroulées et zone de contact.

Le connecteur est fixé sur les contacts insérés à force. Les trous de fixation sur le fond de panier ne sont pas nécessaires. La distance entre les axes de sortie est égale à 2,5 mm ou à une valeur multiple de 2,5. Les sorties des embases sont adaptées aux fonds de panier au pas de 2,5 mm.

NOTE Les informations concernant les fabricants qui ont des composants conformes à la présente spécification particulière sont données dans la liste des produits homologués.

### 1.2 Caractéristiques et conditions nominales de fonctionnement

Tension assignée: Contact/contact pour connecteur complètement chargé (disposition 1)

**Tableau 1 – Tension assignée**

Groupe de matériaux	Degré de pollution	Tension assignée V
I, II, IIIa/b	1	250
II, IIIa/b	2	32
NOTE On fait référence au tableau 14 de cette spécification et au tableau 4 de la CEI 60664-1 donnant la relation entre les lignes de fuite, les degrés de pollution et les groupes de matériaux par rapport aux tensions en valeur efficace.		

Courant nominal: 1 A à 70 °C pour connecteur complètement chargé (disposition 1)

Résistance d'isolement: 10<sup>6</sup> MΩ min. pour PL1 et PL2  
10<sup>5</sup> MΩ min. pour PL3

Catégorie climatique: PL1: 55/125/56  
PL2: 55/125/21  
PL3: 25/100/00

Epaisseur de carte: 1,6 mm à 3,2 mm pour les fiches  
1,6 mm min. pour les embases

Pas entre contacts: 2,5 mm

## 1 General data

### 1.1 Recommended method of mounting

The free board connectors are provided either with solder or with press-in contacts. The mounting of the free board connector is achieved by press-in pivots. The terminations of the free board connectors shall fit into holes in the printed board according to IEC 60326-3, located on a grid of 2,5 mm.

The fixed board connectors are provided either with:

- press-in contacts;
- press-in and wrap contacts;
- press-in and wrap and mating area contacts.

The connector is fixed on the press-in contacts. Fixing holes on the backplane are not necessary. The distance of termination centre lines is 2,5 mm or a multiple of it. The terminations of the fixed board connectors are suited for backplanes having a grid dimension of 2,5 mm.

NOTE Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is given in the Qualified Products List.

### 1.2 Ratings and characteristics

Rated voltage: Contact/contact for fully loaded connector  
(arrangement 1)

**Table 1 – Rated voltage**

Material group	Pollution degree	Rated voltage V
I, II, IIIa/b	1	250
II, IIIa/b	2	32
NOTE Reference is made to table 14 of this specification, and table 4 of IEC 60664-1 listing the relation between creepage distances, pollution degree and material groups versus voltages r.m.s.		

Current rating: 1 A at 70 °C for fully loaded connector (arrangement 1)

Insulation resistance: 10<sup>6</sup> MΩ min. for PL1 and PL2  
10<sup>5</sup> MΩ min. for PL3

Climatic category: PL1: 55/125/56  
PL2: 55/125/21  
PL3: 25/100/00

Printed board thickness: 1,6 mm to 3,2 mm for free board connector  
1,6 mm min. for fixed board connector

Contact spacing: 2,5 mm

### 1.3 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61076. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 61076 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60068-1:1988, *Essais d'environnement – Première partie: Généralités et guide*  
Amendement 1 (1992)

CEI 60297-3:1984, *Dimensions des structures mécaniques de la série de 482,6 mm (19 in) – Troisième partie: Bacs et blocs enfichables associés*

CEI 60326-3:1991, *Cartes imprimées – Partie 3: Etudes et applications des cartes imprimées*

CEI 60352-1:1997, *Connexions sans soudure – Partie 1: Connexions enroulées – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

CEI 60352-5:1995, *Connexions sans soudure – Partie 5: Connexions insérées à force sans soudure – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

CEI 60410:1973, *Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs*

CEI 60512 (toutes les parties) : *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures* (voir la CEI 60512-1-100, 2001)

CEI 60664-1:1992, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, prescriptions et essais*

CEI 60917-2-2:1994, *Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les infrastructures électroniques – Partie 2: Spécification intermédiaire – Dimensions de coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm – Section 2: Spécification particulière – Dimensions pour bacs, châssis, fonds de paniers, faces avant et unités enfichables.*

CEI 61076-1:1995, *Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre d'applications analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données – Partie 1: Spécification générique*  
Amendement 1 (1996)

CEI 61076-4:1995, *Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre d'applications analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données – Partie 4: Spécification intermédiaire: Connecteurs pour cartes imprimées*

CEI 61076-4-102:1997, *Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre d'applications analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données – Partie 4: Connecteurs pour cartes imprimées. Section 102: Spécification particulière pour connecteurs monobroches en deux parties, à usage multiple sur cartes imprimées, aux possibilités de centrage avancé, de codage et d'accouplement avancé, au pas métrique selon la CEI 60917*

### 1.3 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 61076. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this part of IEC 61076 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60068-1:1988, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*  
Amendment 1 (1992)

IEC 60297-3:1984, *Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series – Part 3: Subracks and associated plug-in units*

IEC 60326-3:1991, *Printed boards – Part 3: Design and use of printed boards*

IEC 60352-1:1997, *Solderless connections - Part 1: Wrapped connections - General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-5:1995, *Solderless connections – Part 5: Solderless press-in connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60410:1973, *Sampling plans and procedures for inspections by attributes*

IEC 60512 (all parts): *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements* (see IEC 60512-1-100, 2001)

IEC 60664-1:1992, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 60917-2-2:1994, *Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices – Part 2: Sectional specification – Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice – Section 2: Detail specification – Dimensions for subracks, chassis, backplanes, front panels and plug-in units*

IEC 61076-1:1995, *Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency analogue and in digital high-speed data applications – Part 1: Generic specification*  
Amendment 1 (1996)

IEC 61076-4:1995, *Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency analogue and in digital high-speed data applications – Part 4: Sectional specification – Printed board connectors*

IEC 61076-4-102:1997, *Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency analogue and in digital high-speed data applications – Part 4: Printed board connectors – Section 102: Detail specification for two-part single-pole connectors for multiple uses on plug-in units with pre-centring coding and early mating features, having a metric grid in accordance with IEC 60917.*